



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2013-013

广东汕头超声电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六届六次董事会议，董事张建中先生因公出差未能参会，委托到会董事许统邦先生行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2013 年 5 月 3 日以电子文件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于 2013 年 5 月 8 日上午召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 位董事因公出差未能参会，委托到会董事行使表决权，3 位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本公司符合非公开发行股票的要求，具备非公开发行股票的条件。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于公司 2013 年度非公开发行股票的方案

本公司 2013 年度非公开发行股票的方案如下：

1、发行方式：非公开发行。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

2、发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

3、股票面值：人民币 1.00 元/股。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

4、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过 10500 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

5、限售期：本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

6、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.10 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

7、发行对象：本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他投资者等，发行对象不超过十名。本次发行股票全部采用现金认购方式。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

8、募集资金用途：

本次募集资金总额不超过 85000 万元，拟全部投资以下项目：

项目名称	预 计	计划使用募
------	-----	-------

	投资总额	集资金数额
1) 电容式触摸屏产业化建设项目	60000万元	60000万元
2) 高性能特种覆铜板技术改造项目	25000万元	25000万元

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金或银行贷款投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

9、未分配利润安排：公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

10、发行决议有效期：本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

11、上市地点：限售期满后，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

12、授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜

1) 授权根据具体情况调整和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

2) 授权决定并聘请参与本次非公开发行股票中介机构，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3) 授权办理本次非公开发行股票申报事项；

4) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5) 根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

6) 授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易；

7) 授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

8) 如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。

三、关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案

公司于 2011 年 5 月筹划非公开发行股票编制了本次募集资金项目可行性研究报告，2012 年 9 月获得中国证监会正式批复，但由于资本市场的变化，公司二级市场股票价格自 2012 年 9 月以来一直低于发行底价，公司未能在中国证监会批复文件有效期内完成发行。

根据公司战略发展和建设项目资金需要，公司拟重新启动 2013 年度非公开发行股票工作，鉴于公司原拟投资项目所处的行业竞争状况、技术和产品发展方向、项目建设成本等方面未有大的变化，公司除对项目进度时间计划调整外，不对项目及相关可行性研究报告其他内容进行调整。本次募集资金仍投资电容式触摸屏产业化建设项目和高性能特种覆铜板技术改造项目。

1、电容式触摸屏产业化建设项目

本公司发展电容式触摸屏技术已有 6 年，拥有先进独特的电容式触摸屏专利技术，是大陆较早介入电容屏技术研发并具备规模化制造的厂家之一。随着下游新型电子产品的升级和替换需求激增以及应用领域逐渐拓宽，电容式触摸屏产业正呈现井喷式发展，公司作为国内电容屏技术研发的先行者，很有必要继续利用已有先发优势、把握机遇，加紧实施电容屏产业化建设项目，进一步提升电容屏产业技术与规模，以强化企业产业链地位和竞争力。因此，公司计划实施“电容式触摸屏产业化建设项目”建设，通过在厂区预留场地上新建厂房和配套设施，购置专用制造装备，进一步整合产业上下游资源，优化提升公司电容屏业务与技术，扩大产业规模，新增年产电容式触摸屏 25 万平方米的产能。

本项目计划总投资 60000 万元，其中，固定资产投资 55000 万元，铺底流动资金 5000 万元；项目预计达产年可实现销售收入 12.46 亿元、利润总额 15577 万元，税前内部收益率 19.03%；项目税前静态投资回收期（不含基建期）5.51 年。

2、高性能特种覆铜板技术改造项目

随着电子信息技术的迅猛发展，电子终端产品对印制电路板的功能化、集成化和环保化要求越来越强烈，有效拉动了高端覆铜板制造技术的发展。为把握企业发展机遇，增强覆铜板业务竞争力，以适应高端电子信息终端产品配套需要，公司计划实施“高性能特种覆铜板技术改造项目”的建设，通过在厂区预留场地上增建厂房和购置相关仪器设备对覆铜板生产线进行升级扩建，新增年产 690 万平方米覆铜板及半固化片的生产能力，大幅优化提升公司无铅、无卤、高 Tg、高频、高导热等高性能特种覆铜板产品规模，进一步增强公司覆铜板业务市场竞争力。

本项目计划总投资 25000 万元，其中，固定资产投资 22000 万元，铺底流动资金 3000 万元；项目预计达产年可实现销售收入 52992 万元、利润总额 5368 万元，税前内部收益率 12.10%；项目税前静态投资回收期（不含基建期）7.98 年。

该项表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2007 年 12 月募集的人民币普通股资金截至 2012 年 12 月 31 日止的使用情况报告。情况如下：

（一）前次募集资金情况

本公司于 2007 年 10 月 25 日获中国证券监督管理委员会以证券发行字[2007]376 号文核准非公开发行不超过 6000 万股股票，实际发行数量为 5250 万股，发行价格每股 7.17 元，募集资金总额为 37,642.50 万元，扣除 1,417.15 万元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费、登记费、其他费用等）后的实际募集资金净额为 36,225.35 万元。保荐机构东方证券股份有限公司于 2007 年 12 月 24 日向本公司汇入人民币 36,342.50 万元（含未支付的发行费用 117.15 万元），上述募集资金款项已经中和正信会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月 28 日出具“中和正信验字(2007)第 7—025 号”验资报告验证。

本公司根据相关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《广东汕头超声电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2007 年 2 月 8 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。该《管理办法》对公司募集资金的存放、管理、使

用、变更使用范围的决策程序以及募集资金使用情况的报告和监督等内容进行了严格的规定。根据《管理办法》，公司和保荐机构东方证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司汕头支行、中国银行股份有限公司汕头分行两家银行于 2008 年 1 月 31 日签订了《募集资金三方监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。公司按前述《管理办法》和协议对募集资金严格管理，开立专户存放，实行专款专用，严格按照募投项目投资计划投入。

截止 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金在专项账户存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行汕头分行	803016386008096001	134, 171, 475. 23	0
中国光大银行汕头支行	78100188000069116	229, 253, 524. 77	0
合计		363, 425, 000. 00	0

（二）前次募集资金实际使用情况

将本公司前次募集资金实际使用情况与《2007 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况列示如下

单位：人民币万元

募集资金总额：36225. 35	已累计使用募集资金总额：36225. 35
	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0	2007 年：0
变更用途的募集资金总额比例：0	2008 年：36225. 35
	2009 年：0
	2010 年：0
	2011 年：0
	2012 年：0

投资项目			项目中募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造	高 密 度 互 连（HDI）印制电路板产业升级技术改造	24340	24340	24908.67	24340	24340	24908.67	568.67	2008 年 7 月 1 日
2	超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造	超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造	13300	11885.35	12112.76	13300	11885.35	12112.76	227.41	2008 年 4 月 1 日
合 计			37640	36225.35	37021.43	37640	36225.35	37021.43	796.08	

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目与承诺一致。

3、前次实际募集资金与上市公告书披露的计划利用募集资金对照情况

本公司上市公告书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为 37,640 万元，实际募集资金净额为 36,225.35 万元，不足部分由公司自筹解决。

募集资金到位后，本公司分别向控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司和分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂划付募集资金人民币 24,340 万元和 11,885.35 万元，用于募集资金项目的建设。截止 2012 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 36,225.35 万元，其中用于置换募集资金未到位前以自有资金和银行借款先期投入的金额为 25,334 万元，实际新增投入募投项目的募集资金金额为 10,891.35 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金计划情况，所募资金已全部投入募投项目建设。

4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下：

（1）项目募集资金实际投入与承诺一致，不存在差异：

“高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造”项目募集资金总额为 24340 万元，实际投入 24340 万元；“超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造”项目募集资金总额为 11885.35 万元，实际投入 11885.35 万元。

(2)项目实际投资总额与承诺投资总额差异的说明：

“高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造”项目实际总投资 24908.67 万元，比承诺总投资 24340 万元多投入 568.67 万元，主要是因为项目投产初期个别月份实际产销量超过预计产量而相应增加生产备料等流动资金投入所致。

“超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造”项目实际总投资 12112.76 万元，比承诺总投资 13300 万元少投入 1187.24 万元，主要是因为项目在建设过程中经及时应用公司最新工艺技术研究开发成果，在确保项目生产能力和技术水平情况下减少购置 1 台上胶机所致。

5、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目。

6、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无将闲置募集资金用于其他用途的情况。

7、截止 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕。

8、前次募集资金实际使用的说明

根据公司第四届董事会第五次会议审议，募投项目——高密度互连（HDI）印制板产业升级改造的建设由本公司控股子公司（本公司持股 75%）汕头超声印制板（二厂）有限公司实施。公司拟以募集资金 24,340 万元增资投入汕头超声印制板(二厂)有限公司，外方股东按相应比例投入资金 8,113 万元。

由于定向增发融资工作时间较长，募集资金到位时间较原计划延缓，期间外方股东由于经营资金发生变化仅能投入部分增资款。因此，经公司第四届第十七次董事会及 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，决定调整该项目投资方式：募集资金 24340 万元中，本公司以中方股东名义以增资方式投入汕头超声印制板（二厂）有限公司的募集资金 4350 万元（约折合 630 万美元），外方股东香港汕华发展有限公司按相应比例以现金增资 210 万美元（约折合人民币 1450 万元），剩余募集资金 19990 万元以借款方式提供汕头超声印制板（二厂）有限公司用于高密度互连（HDI）印制板产业升级改造项目的建设。相关决议内容刊登于 2008 年 7 月 19 日及 2008 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网予以披露。

上述增资实施时由于汇率变动的影 响，实际投入的募集资金为 4323.69 万元（折合 630 万美元），以借款方式投入募集资金为 20016.31 万元。

（三）前次募集资金投资项目实现效益情况

将本公司前次募集资金实际使用情况与《可行性研究报告》的收益预测进行对照，具体如下：

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	截止日累计承诺效益	最近五年实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008	2009	2010	2011	2012		
1	高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造	97.40%	22393	916	5342	5294	6544	4684	22780	是（101.73%）
2	超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造	115.79%	15241	1053	1394	3639	3124	1997	11207	否（73.53%）

	合计	--	37634	1969	6736	8933	9668	6681	33987	否 (90.31%)
--	----	----	-------	------	------	------	------	------	-------	------------

编制说明：

1、投资项目承诺效益情况

(1) 高密度互连 (HDI) 印制电路板产业升级技术改造项目已于 2008 年 7 月正式投产，截至 2012 年 12 月 31 日实际投产运营时间为 4 年 6 个月；根据项目《可行性研究报告》承诺，项目投产第一年至第四年分别可实现效益 3093 万元、6532 万元、6014 万元和 4871 万元，投产第五年前 6 个月可实现效益 1883 万元，所以至截止日累计承诺实现效益为 22393 万元。

(2) 超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目已于 2008 年 4 月正式投产，截至 2012 年 12 月 31 日实际投产运营时间为 4 年 9 个月；根据项目《可行性研究报告》承诺内容，项目投产第一年至第四年分别可实现效益 786 万元、2267 万元、4669 万元和 4572 万元，投产第五年前 9 个月可实现效益 2947 万元，所以至截止日累计承诺实现效益为 15241 万元。

(3) 本公司前次募集资金投入产生的实际效益及形成的资产已计入并反映于最近五年的财务报告中。

2、前次募集资金实际效益的计算口径与方法

项目可行性研究报告承诺项目建成投产后至截止日累计实现利润 37,634 万元，项目实际效益 33,987 万元是根据高密度互连 (HDI) 印制电路板产业升级技术改造项目和超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目产生的毛利减去应分摊的期间费用测算的项目利润。

(四) 前次发行中无以资产认购股份的情况。

(五) 将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告 (中期报告) 和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案（见公告编号：2013-014）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日